

第1回

東アジア

# イノベーション促進フォーラム

-East Asia Innovation Accelerator Forum-

~The 1st Korea-China-Japan Joint Symposium 2018 :

Creating Value Through Interdisciplinary Collaboration for the 4th Industrial Revolution~

世界のものづくりの中心、東アジア。その東アジアから新たな時代のイノベーションを発信するために日中韓の大学が共同で開催するシンポジウムです。

国際的共同研究や産学連携によるイノベーション促進の試みや、環境、ICT、機械/材料分野における革新的技術など、イノベーションに関わる研究発表を募集します。

2018年

8月20日(月)~8月21日(火)

場所：東義大学校 情報工学館（釜山広域市，韓国）

-8月20日(月)-

9:00~12:00 全体会  
13:00~15:00 学生によるポスターセッション  
15:00~18:00 分科会

「テーマ」

- ・環境
- ・機械/材料分野
- ・IT
- ・産学連携

-8月21日(火)-

9:00~12:00 テクニカルツアー

参加大学（予定）：

【日本】北海道大学，金沢大学，室蘭工業大学，東北大学

【中国】北京科技大学，ハルビン工業大学，ハルビン工程大学

長春理工大学，中国科学院大学

【韓国】忠南大学校，東義大学校，忠北大学校

★北大の学生は選考により  
旅費支援があります！

お問い合わせ先

第1回・東アジアイノベーション  
促進フォーラム事務局

e-mail:[eaf@eng.hokudai.ac.jp](mailto:eaf@eng.hokudai.ac.jp)

# East Asia

## Innovation Accelerator Forum

~The 1<sup>st</sup> Korea-China-Japan Joint Symposium 2018 :  
Creating value through interdisciplinary collaboration for the 4<sup>th</sup> industrial revolution~

This symposium, which will be jointly held between universities in Korea, China, and Japan, aims to disseminate innovation from East Asia for the next industrial revolution.

It will discuss efforts to accelerate innovation through means such as joint international research and industry-university cooperation, as well as introduce the latest technologies in the fields of environmental science, ICT, material science, and mechanical engineering.

# AUG. 20<sup>th</sup> MON ~ 21<sup>st</sup> TUE, 2018

Venue : Information Engineering Building, Dong-eui University (Busan, Korea)

### -20<sup>th</sup> AUG(MON)-

9:00~12:00	<b>General session</b>
13:00~15:00	<b>Poster sessions</b> by students/companies
15:00~18:00	<b>Sub-sessions</b>

「Topics」 · Mechanical Engineering / Material Science · ICT  
· Environmental Science · Industry-university cooperation

### -21<sup>st</sup> AUG(TUE)-

9:00~12:00	<b>Technical tour/Sub-sessions</b>
------------	------------------------------------

Participating Universities (tentative) :

【Korea】 Chungbuk National University, Chungnam National University, Dong-eui University

【China】 Changchun University of Science and Technology, Harbin Engineering University, Harbin Institute of Technology, University of Chinese Academy of Sciences, University of Science and Technology Beijing

【Japan】 Hokkaido University, Kanazawa University, Muroran Institute of Technology, Tohoku University

CONTACT

East Asia Innovation Accelerator Forum Office

e-mail: [eaf@eng.hokudai.ac.jp](mailto:eaf@eng.hokudai.ac.jp)